

## HKPCA 与 CPCA 联合研讨会课程招生简章

HDI 板近年来主要应用于智能手机上，在 2017 年更迎来了采用先进 MSAP 工艺的高价 HDI 板，mSAP 工艺在 2018 年持续渗透并将在未来几年进一步助力 PCB 市场发展。

Smart phones are the key users of HDI boards in recent years. 2017 saw the introduction of high technology and advanced HDI(mSAP). The penetration of mSAP continued through 2018 and will further help the development of PCB market in the next few years.

为帮助会员抢占市场先机，HKPCA 与 CPCA 联合于 2019 年 8 月 23 日（星期五）在东莞举办「HDI 生产技术及可靠性要求研究」研讨会。

In order to help members seize the market opportunities, HKPCA and CPCA will jointly hold a seminar on "Research on HDI manufacturing Technology and Reliability Requirements" in Dongguan on Friday, August 23rd, 2019.

主办单位 Organizer	香港线路板协会 (HKPCA) 、中国电子电路行业协会 (CPCA)			
时间 Time:	2019 年 8 月 23 日 (星期五) 上午 9 点到下午 4 : 30 / 9:00am-4:30pm on Aug.23,2019			
地点 Venue:	东莞市柏宁长安国际酒店三楼宴会 2 号厅 东莞市长安镇德政中路 222 号			
培训目的 Objective:	帮助学员对 HDI 及其可靠性有更多更广泛的认识 Provide audience a wider understanding of HDI and its reliability tests			
研讨会对象 Target Audience:	生产 HDI 及有意于涉足更高级 HDI 板的 PCB 生产厂商 PCB manufacturers who manufacture HDI and are interested in manufacturing more advanced HDI boards			
课程内容 Seminar Content:	时间	课程安排	讲师	公司
	08:40	报到	/	/
	09:00-12:00	HDI 生产技术及可靠性要求研究 HDI Manufacturing Technology and Reliability Requirements Research	苏新虹	珠海方正印刷电路板 发展有限公司 Founder PCB
	12:00-13:30	午餐		
	13:30-16:30	最有效的微通孔金属化工艺 The most effective way for Microvia Metallization Process	陈楚文/ 陈裕锜	麦德美化学处理方案 有限公司 Macdermid Alpha
备注：课题大纲及讲师简介（请见第 3-4 页）；因课程具体内容需要，讲师可对授课时间、内容作临时性调整！				

# HKPCA / CPCA

费用 Fee:	1. HKPCA 会员 – 每位 RMB500 或 HKD580 (费用包括讲义、午餐、茶歇) 2. 非 HKPCA 会员 – 每位 RMB800 或 HKD 930 (费用包括讲义、午餐、茶歇) 3. 住宿自理	
缴款办法 Payment Method:	人民币电汇： 户名： 港粤线路板科技咨询（深圳）有限公司 开户行： 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 帐号：7559 1878 8810 201 深圳秘书处地址： 中国广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 26 楼 2607	港幣電匯： 銀行名稱：香港上海滙豐銀行有限公司 帳戶名稱：香港綫路板協會有限公司 帳戶號碼：469-089601-838 銀行電匯編號：HSBCHKHHHKH 香港辦事處地址：香港九龍觀塘成業街 7 號寧晉中心 22 樓 B 室
<b>电汇截止日期：2019 年 8 月 20 日</b>		
查 询 Enquiry:	深圳秘书处： 全小姐 Eva Quan; Tel#: (86) 755 8624 0020; Email ID: <a href="mailto:evaquan@hkPCA.org">evaquan@hkPCA.org</a> 袁小姐 Susan Yuan; Tel#: (86) 755 8624 1673; Email ID: <a href="mailto:susanyuan@hkPCA.org">susanyuan@hkPCA.org</a>	
地图 Map:		

<b>课题一</b>	<b>HDI 生产技术及可靠性要求研究</b> <b>Research on HDI manufacturing Technology and Reliability Requirements</b>
<b>大纲内容</b> <b>Content:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、 HDI 电路板市场规模及应用领域 Market and application field for HDI</li> <li>二、 手机用 HDI 电路板的技术要求 Technical requirements for HDI in mobile phone application</li> <li>三、 细线路制作 Fine line Manufacturing:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 细线路对电镀铜均匀性要求 The requirements of distribution of Copper Plating for fine line manufacturing</li> <li>2. 真空蚀刻技术 Vacuum etching technology</li> <li>3. 二流体技术 Two-fluid technology</li> </ul> </li> <li>四、 HDI 电路板材料介绍及层压工艺技术 Introduction of material and laminating technology for HDI manufacturing</li> <li>五、 HDI 电路板可靠性要求 The reliability requirements for HDI               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. HDI 电路板可靠性测试项目 The reliability tests for HDI</li> <li>2. 测试方法及频率 Test method and frequency</li> <li>3. 失效分析 Failure Analysis</li> </ul> </li> </ul>
<b>讲师简介</b> <b>Introduction to speaker:</b>	<p>苏新虹先生毕业于武汉大学及电子科技大学，获物理化学学士学位及软件工程硕士学位。1989 年进入电路板行业，在电路板公司担任过工艺部经理、品质部经理，从事过 HDI 工厂的筹建工作，目前在珠海方正印刷电路板发展有限公司任研究院副院长，负责公司的技术研发、技术管理工作。</p> <p>Mr. Su Xinhong graduated from Wuhan University and University of Electronic Science and Technology China with a bachelor's degree in physical chemistry and a master's degree in software engineering respectively. In 1989, he joined PCB industry and worked as process manager and quality manager, and later he had engaged in the build-up preparation of HDI factory. Currently, Mr.Su is Vice President of R&amp;D Institute of Zhuhai Founder PCB Development Co., Ltd. and is responsible for R&amp;D and technical management for the company.</p>
<b>课题二</b>	<b>最有效的微通孔金属化工艺</b> <b>The most effective way for Microvia Metallization Process</b>
<b>大纲内容</b> <b>Content:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 介绍不同类型的直接电镀 Introduction on various types of Direct Metallization</li> <li>2. 在微通孔制造上，直接电镀的选择 Choice of DM in microvia fabrication</li> <li>3. 介绍填孔工艺 Via-Fill Process Introduction</li> <li>4. 微通孔的可靠性研究 A Study of microvia reliability</li> <li>5. 微通孔金属化的总体系统方案 System Approach for total solution for microvia metallization</li> </ul>

讲师简介 Speaker introduction:	<p>陈楚文先生毕业于华南理工大学，获材料科学与英语专业双学位。2010年12月至今，在麦德美化学处理方案有限公司(麦德美乐思)公司任职中国区金属化产品/业务发展经理以及华南金属化生产经理。负责金属化业务发展、直接金属化策略及高级产品支持。此前曾于安美特(广州)有限公司任PTH产品华南应用经理，为公司培训师，负责地区产品支持，主要为PTH产品应用，包括典型的离子及胶体钯系统及直接金属化产品。</p> <p>Mr. Chen Chuwen graduated from South China University of Science and Technology with a double degree in Materials Science and English. From December 2010 to now, he worked in Macdermid Enthone company as the Manager of Metallized Product in China and Business Development manager in South China. He is responsible for metallization business development, direct metallization strategy and advanced product support. Previously to Macdermid Enthone, he served in Atotech (Guangzhou) as an application manager of PTH products in South China and he was a trainer of Atotech. During this period, he was in charge of regional product support, mainly for PTH product application, including typical ion and colloidal palladium system and direct metallization products.</p> <p>陈裕琦先生毕业于香港浸会大学及香港城市大学，获得应用化学学士及材料科技及管理学硕士学位。陈先生在PCB行业有17年工作经验，精通PTH/DMSE及电镀工艺，熟悉PCB行业的实践与要求。2013年至今，他在MacDermid Alpha公司任职亚洲区线路板电镀产品经理，负责亚洲区市场活动及技术支持。曾于1995年-1998年香港生产力促进局(HKPC)任职项目工程师；2001-2013年于安美特公司工作，历任安美特广州技术主管、线路板电镀高级产品专员。</p> <p>Mr. Thomas Chan graduated from the Hong Kong Baptist University and the City University of Hong Kong, who received a bachelor and master's degree in Applied Chemistry and Materials Science and Technology and Management respectively. 17 years of experience in PCB industry, Mr. Chan's major is in PTH/DMSE &amp; Electroplating, and he is familiar with practice &amp; requirement of PCB industry. From 2013 to date, he works as the product manager of the electro-plating of PCB in Macdermid Enthone of Asia region, he is responsible for Market and the Technical Support in Asia-Pacific Region. From 1995 to 1998, he worked in Atotech as a Technical Centre Supervisor of PCB lab &amp; pilot line management and later as a Product Specialist (Senior) of PCB electroplating for product marketing &amp; customer support. Prior to that, he worked at the Hong Kong Productivity Council (HKPC) as a project engineer from 2001-2013.</p>
----------------------------------	---

## 回条 Reply Form

### 2019 年 08 月份研讨会

日期：2019 年 8 月 23 日 (星期五)  
 时间：9:00 - 17:00  
 地点：东莞市柏宁长安国际酒店三楼宴会 2 号厅

请于 2019 年 8 月 20 日(星期二)前回复  
 Please reply by August 20, 2019 (Tues.)  
 电邮地址 Email ID : [evaquan@hkpca.org](mailto:evaquan@hkpca.org)  
[susanyuan@hkpca.org](mailto:susanyuan@hkpca.org)

#### 参加者详情：

人数	参加者姓名(必填)		职位	参加研讨会者	是否需要 研讨会证
	英文	中文		手机号(必填)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

#### 说明：

- 1、需要研讨会证的学员请在「是否需要研讨会证」一栏中进行选择，并填妥中英文名，无中文名的除外。
- 2、研讨会证将在当次研讨会课程结束后，发放给学员本人；若参加者有变动请于截止日期前通知本会。

对是次课程之期望 ( 请务必填写 ) : \_\_\_\_\_

费用 ( 备注：不设现场收费，烦请于课程至少三天前付清 )：

参加人数共 \_\_\_\_\_ 人 每人港币/人民币 \_\_\_\_\_ = 合共总额港币/人民币 \_\_\_\_\_

公司开票资料：抬头： \_\_\_\_\_  
 纳税编码： \_\_\_\_\_

#### 联络人信息：

姓名： \_\_\_\_\_ 电话号码： \_\_\_\_\_  
 公司名称： \_\_\_\_\_  
 公司地址： \_\_\_\_\_  
 电邮地址： \_\_\_\_\_ 传真号码： \_\_\_\_\_

**\*\*\*截止报名日期: 2019 年 8 月 20 日(星期二)\*\*\***